

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第2区分
 【発行日】平成19年1月18日(2007.1.18)

【公開番号】特開2005-268534(P2005-268534A)
 【公開日】平成17年9月29日(2005.9.29)
 【年通号数】公開・登録公報2005-038
 【出願番号】特願2004-78782(P2004-78782)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 25/065 (2006.01)
H 0 1 L 25/07 (2006.01)
H 0 1 L 25/18 (2006.01)
H 0 1 L 21/60 (2006.01)
H 0 1 L 21/3205 (2006.01)
H 0 1 L 23/52 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 25/08 Z
 H 0 1 L 21/60 3 0 1 N
 H 0 1 L 21/88 T

【手続補正書】

【提出日】平成18年11月24日(2006.11.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

主面上にチップ上配線が形成され、当該チップ上配線が外部接続配線と電氣的に接続されるよう構成された半導体チップであって、

前記チップ上配線は、前記主面の第1の端部の側から第2の端部の側に延伸するように形成されていることを特徴とする半導体チップ。

【請求項2】

第1の主面上に第1のチップ上配線が形成された第1の半導体チップと、

当該第1の主面上に積層された、第2の主面上に第2のチップ上配線が形成された第2の半導体チップと、

前記第1のチップ上配線または前記第2のチップ上配線に電氣的に接続される、複数の外部接続配線と、を有する積層型半導体装置であって、

前記第2の半導体チップは、前記第1のチップ上配線の少なくとも一部が露出するようにずらして積層され、

前記第2のチップ上配線は、前記第2の主面の、第1の端部の側から第2の端部の側に延伸するように形成され、前記第1のチップ上配線または前記外部接続配線と電氣的に接続される構造であることを特徴とする積層型半導体装置。

【請求項3】

前記第1のチップ上配線は、前記第2のチップ上配線を介して前記外部接続配線に電氣的に接続される構造であることを特徴とする請求項2記載の積層型半導体装置。

【請求項4】

前記第2のチップ上配線は、前記第1のチップ上配線を介して前記外部接続配線に電氣的に接続される構造であることと特徴とする請求項2記載の積層型半導体装置。

【請求項 5】

前記外部接続配線は、リードフレームからなることを特徴とする請求項 2 乃至 4 のうち、いずれか 1 項記載の積層型半導体装置。

【請求項 6】

前記外部接続配線は、テープキャリアに形成された配線であることを特徴とする請求項 2 乃至 4 のうち、いずれか 1 項記載の積層型半導体装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0013】

また、上記の問題は第 1 の主面上に第 1 のチップ上配線が形成された第 1 の半導体チップと、当該第 1 の主面上に積層された、第 2 の主面上に第 2 のチップ上配線が形成された第 2 の半導体チップと、前記第 1 のチップ上配線または前記第 2 のチップ上配線に電氣的に接続される、複数の外部接続配線と、を有する積層型半導体装置であって、前記第 2 の半導体チップは、前記第 1 のチップ上配線の少なくとも一部が露出するようにずらして積層され、前記第 2 のチップ上配線は、前記第 2 の主面の、第 1 の端部の側から第 2 の端部の側に延伸するように形成され、前記第 1 のチップ上配線または前記外部接続配線と電氣的に接続される構造であることを特徴とする積層型半導体装置により、解決する。